


安全评价报告信息公开表格 (浙江芯科半导体有限公司)

被评价单位名称		宝鼎乾芯集成电路(杭州)有限公司
评价项目名称/项目编号		第三代半导体材料研发线新建项目(公共服务平台)安全预评价/第2208043号
项目简介(含图片)		<p>本项目为芯片生产企业,租用杭州富春湾新城资产运营管理有限公司厂房3110平方米。新增年产55000片碳化硅功率芯片生产线。项目总投资7954.76万元,其中设备投资6346.53万元。建成后预计实现销售收入5500万元,年利税4000万元</p>
		
		
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		夏宇科
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		赵颖斌
评价报告编制人		夏宇科、汪胜红
报告审核人		张奇峰
参与评价工作	安全评价师	夏宇科、汪胜红
	注册安全工程师	夏宇科、汪胜红
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	夏宇科、汪胜红
	时间	2022.8.25~2022.9.10
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2022.9.10